甄試組別 /名額	己組(系統晶片組【IC設計領域聯合招生】) 一般生 3 名
甄試項目	一、初審(佔60%) 請將下列資料依序存成PDF檔上傳: 1、初審基本資料表(請依本系附件格式) 2、大學歷年成績單(需含學業成績總名次證明;同等學力者以最高學歷歷年成績單代替) 3、讀書計畫 4、其他有助於審查之資料(如英語能力證明、參與撰寫之研究報告、專題報告、學術論文等) ※一般生 【除初審特優逕行錄取者外,依初審成績順序至多通知甄試名額5倍之考生參加複 試】 二、複試 1.面試(佔40%) 以中文及英文雙語方式進行
總成績 計算方式	○ 初審成績特優者:依初審成績逕行錄取。○ 其他考生總成績:初審成績*60%+複試成績*40%。(各單項成績滿分均爲100分)
	◎ 初審成績特優者,逕行錄取,名額上限爲1名。◎ 參加面試考生:比較總成績錄取;總成績相同時,依【複試成績】成績高低順序錄取。
甄試 日期	尚未訂定(114年11月07日~114年11月13日)
甄試 費用	1300元